

波峰焊接工艺

波峰焊接工艺是PCB产品的传统处理方式。联捷电气提供了各种类型和各种焊针间距的PCB产品，PA材料的塑件外壳能耐受波峰焊接的高温。

回流式焊接工艺

回流式焊接工艺是针对表面贴装组件的标准处理方式。回流式焊接产品可以在相同的回流焊接过程中同SMD器件一起插入并进行焊接。无需分别进行焊接，从而降低了费用。

PressIn技术 免焊接的连接方式

Press-in即指针与PCB的直接连接，而无需额外的焊接过程。专门设计的Press-in针确保了较小的压入力和高紧固力，而弹性的压入区又为与PCB板的连接处提供了保护。



导线的构造和尺寸

导线截面 [mm²]	单股导线		多股导线		细股导线		线号 AWG	美制导线规格(AWG)					
	最大直径	芯线根数	最大直径	芯线根数 (最少根数)	最大直径	芯线根数 (参考值)		单股导线		多股导线			
	[mm]							[φ mm]	[circ.miles]	[mm²]	[φ mm]	[circ.miles]	[mm²]
0.2	0.5	1	-	-	-	-	24	0.51	404	0.21	-	-	-
0.5	0.9	1	1.1	7	1.1	16	20	0.81	1022	0.52	0.91	1111	0.56
0.75	1.0	1	1.2	7	1.3	24	18	1.02	1620	0.82	1.16	1600	0.82
1	1.2	1	1.4	7	1.5	32	(17)	1.15	2050	1.04	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	16	1.29	2580	1.31	1.50	2580	1.32
1.5	1.5	1	1.7	7	1.8	30	(15)	1.45	3260	1.65	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14	1.63	4110	2.08	1.85	4100	2.09
2.5	1.9	1	2.2	7	2.3	50	(13)	1.83	5180	2.63	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12	2.05	6530	3.31	2.41	6500	3.32
4	2.4	1	2.7	7	2.9	56	(11)	2.30	8230	4.17	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10	2.59	10380	5.26	2.95	10530	5.37
6	2.9	1	3.3	7	3.9	84	(9)	2.91	13100	6.63	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8	3.26	16510	8.37	3.73	16625	8.48
10	3.7	1	4.2	7	5.1	80	(7)	3.67	20800	10.56	4.15	20820	10.55
-	-	-	-	-	-	-	6	4.12	26240	13.30	4.67	26250	13.39
16	4.6	1	5.3	7	6.3	126	(5)	4.62	33100	16.77	5.24	33100	16.77

电流负荷能力

印刷线路板接线端子及接插件的电流负荷能力取决于多个技术参数。除结构外，还包括以下几个方面：

- 所用材料（金属和绝缘材料）
- 并排相邻的位数
- 导线连接点的处理
- 导线截面积
- 印刷电路板上元器件的布置
- 环境温度

电流负荷能力这一参数指的是在正常情况下，相邻的5位同时有电流流过时，既不会因发热对元件造成损害，也不会影响元件的功能。有关环境温度的影响可参照各个产品的温度曲线。